

1. 適用範囲

本規格は、プリント基板とシャーシ部材等との接続に用いられるアース用金具、シールドフィンガー 1715 について規定する。

2. 適用規格

以下の規格を本規格の一部として適用する。

JIS (Japanese Industrial Standard: 日本工業規格)

3. 適用型番

本規格は、以下の製品型番に対して適用される。

型番: 0-1447360-9

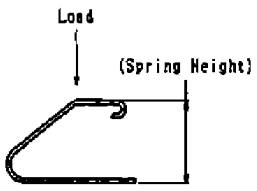
旧型番: 3100069

4. 材質

金属材料: JIS C1720R ベリリウム銅 (ミルハードン材)

メッキ: ニッケル下地金メッキ 0.05 μm MIN. (前めっき)

5. TEST PROCEDURES AND PERFORMANCE

No.	Title	Test Procedures	Performance
5.1	Mechanical Performance		
5.1.1	Spring Capacity	Measure the spring force, after making 10 times flexion to take one's position at 2mm/min. speed. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>The diagram shows a cross-section of a spring component. A vertical arrow labeled 'Load' points downwards from the top of the component. A horizontal dimension line is drawn across the top of the component, labeled '(Spring Height)'.</p> </div>	As spring height 1.4 mm Spring Force: 0.2N (20gf) min.

番号	項目	試験方法	性能						
5.2	実装適合性								
5.2.1	半田付性	<p>JIS C0050に基づき、下記の条件で試験を行う。</p> <table border="1" data-bbox="440 737 878 863"> <tr> <td>半田温度</td> <td>235±5℃</td> </tr> <tr> <td>半田浸漬時間</td> <td>2±0.5 秒</td> </tr> <tr> <td>フラックス</td> <td>NA-200</td> </tr> </table>	半田温度	235±5℃	半田浸漬時間	2±0.5 秒	フラックス	NA-200	<p>・半田付け部の75%以上が新しい半田コーティングで覆われること。(破断面は除く)</p>
半田温度	235±5℃								
半田浸漬時間	2±0.5 秒								
フラックス	NA-200								

SHIELD FINGER 1715
シールドフィンガー 1715

注記) 5 ページ以降日本語版

1. Scope

This specification applies to the SHIELD FINGER 1715 which is used for grounding terminal between a printed wiring board and a metal frame.

2. Relevant Standards

The standards below are applicable as part of this specification.

JIS (Japanese Industrial Standard)

3. Types

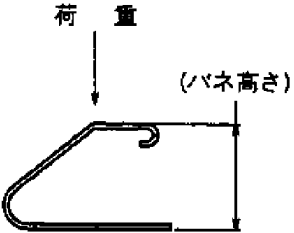
Part No. : 0-1447360-9 Old Part No. 3100069

4. Material

Contact: Beryllium Copper Alloy (JIS C1720R)

Plating: Gold Plate 0.05 μ m MIN. Over Nickel Plate

5. 試験方法及び性能

番号	項目	試験方法	性能				
5.1	機械的性能						
5.1.1	バネ特性	<p>試料に図示の方向から所定のバネ高さまでたわみを繰り返し与え、試験後のバネ圧を測定する。</p> <table border="1" data-bbox="483 793 813 856"> <tr> <td>繰返速度</td> <td>2mm/min.</td> </tr> <tr> <td>繰返回数</td> <td>10回</td> </tr> </table> 	繰返速度	2mm/min.	繰返回数	10回	バネ高さ1.4 mmの時 バネ圧: 0.2N (20gf) min.
繰返速度	2mm/min.						
繰返回数	10回						

No.	Title	Test Procedures	Performance				
5.2	Process Compatibility Requirements						
5.2.1	Solderability	<p>The solderability test shall be performed per JIS C0050.</p> <table border="1" data-bbox="367 793 943 877"> <tr> <td data-bbox="367 793 732 833">Molten solder Temperature</td> <td data-bbox="735 793 943 833">235 ± 5°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 837 732 877">Immersion Time in Solder</td> <td data-bbox="735 837 943 877">2 ± 0.5 sec.</td> </tr> </table>	Molten solder Temperature	235 ± 5°C	Immersion Time in Solder	2 ± 0.5 sec.	<p>The solder tails shall have been covered with new solder over a minimum of 75% of the solderable area.</p>
Molten solder Temperature	235 ± 5°C						
Immersion Time in Solder	2 ± 0.5 sec.						